50微米半固化纯胶片 EB050

产品名称	50微米半固化纯胶片 EB050
公司名称	苏州工业园区广惠科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:苏州广惠百强(BENCH)牌 型号:EB050
公司地址	中国 江苏苏州市金阊区西环路2898号
联系电话	86-051265575611 13913183279

产品详情

半固化胶片一种树脂组合物，其主要包括环氧树脂、硬化促进剂、交联剂以及含磷树脂，该含磷树脂为9，10-二氢-9-氧杂-10-磷菲-10-氧化物或其衍生物所取代的双酚酚醛树脂或酚醛树脂，半固化胶片可应用于电路基板绝缘层,起到多层电路板的连结作用。该树脂组合物经由加热而形成半固化态。

半固化胶片树脂组合物中，环氧树脂较佳包括至少一种双酚a (b i spheno 1a)环氧树脂、双酚f(bisphenol f)环氧树脂、双酚s(bisphenol s)环氧树脂、酚醛(phenol novolac)环氧树脂、双酚a酚醛（bisphenol a novolac)环氧树脂、邻甲酚（o-cresol novolac)环氧树脂、三官能基（trifunctional)环氧树脂、四官能基(tetrafunctional)环氧树脂、多官能基（multifunctional)环氧树脂、二环戊二烯环氧树脂(dicyclopentadiene (dcpd) epoxy resin)、含磷环氧树脂、对二甲苯环氧树脂(p-xylene epoxy resin)、萘型（naphthalene)环氧树脂、苯并哌喃型（benzopyran)环氧树脂、联苯酚醛（biphenyl novolac)环氧树脂、酚基苯烷基酚醛（phenol aralkyl novolac)环氧树脂或其组合。此外，环氧树脂更佳选自三官能基环氧树脂、四官能基环氧树脂及多官能基环氧树脂，其可有效提高树脂组合物间各树脂的交联性，且可进一步提高树脂的耐热性及固化后的机械强度。

半固化胶片树脂组合物中，硬化促进剂较佳选自咪唑（imidazole)、三氟化硼胺复合物、氯化乙基三苯基膦（ethyltriphenyl phosphonium chloride)、2_甲基咪唑(2-methylimidazole, 2mi)、2_苯基咪唑(2-phenyl-lh-imidazole, 2pz)、2_乙基-4-甲基咪唑q-ethyl-4-methylimidazole，2e4mz)、三苯基膦(triphenylphosphine, tpp)、4-二甲基胺基吡啶（4-dimethylaminopyridine，dmap)等一种或多种的路易斯碱，或选自锰、铁、钴、镍、铜及锌的金属盐化合物等一种或多种路易斯酸。

半固化胶片树脂组合物中，交联剂较佳包括二胺基二苯砜（diaminodiphenyl sulfone, dds)，其具有高玻璃转化温度、高耐热性及高储期等特性，可有效提升和环氧树脂的交联固化作用；此外，树脂组合物更可进一步包括至少一种选自以下群组的交联剂、其改质物或其组合：氰酸酯树脂、苯酚树脂、酚醛树脂（phenol novolac resin)、苯乙烯树脂、聚丁二烯树脂、聚苯醚（polyphenyl ether)树脂、酸酐（anhydride)化合物、胺基化合物及苯并恶嗪（benzoxazine)树脂。

半固化胶片树脂组合物中，含磷树脂系为由dopo或其衍生物所取代的双酚酚醛（bisphenol novolac,bpn)树脂或酚醛（phenol novolac,pn)树脂。树脂组合物具有高玻璃转化温度（tg)、高耐热性、难燃、高储期等特性，且可应用于半固化胶片、金属箔层合板及电路板等。含磷树脂较佳为含dopo官能基的树脂，如dopo-pn或d0p0-bpn,且其中dopo-bpn可为d0p0-bpan(d0p0_bisphenol anovolac)、dopo-bpfn(dopo-bispheno1 f novolac)、d0p0-bpsn(d0p0_bisphenol s novolac)等双酚酚醛化合物。

以d0p0-bpan树脂为例，其中dopo官能基接合于具有长链接的bpan树脂上并提供阻燃性，而bpan树脂上的羟基提供其与它种树脂（如环氧树脂）的交联性。长链结构的bpan除可提供多个羟基与它种树脂交联作用外，接合于bpan上的dopo官能基将可较均匀地分布在该树脂结构上。

半固化胶片树脂组合物，包括以下成分：

(a) 100重量份的双酚a环氧树脂

(b)40重量份的苯酚酚醛（phenolic novolac)树脂

(c) 20重量份的dds

(d) 20重量份的d0p0-bpan树脂

(e) 0. 1重量份的二甲基咪唑

将所描述的树脂组合物于一搅拌槽中混合均匀后再涂布于pet聚酯保护膜表面，并经由加热烘烤成半固化态，再在表面覆盖上一层离型膜。

dopo为树脂组合物中常用的添加剂，其主要目的在于提高树脂组合物的阻燃性，以使树脂组合物应用于高温环境时仍可保持稳定性。dopo是为无卤素环氧树脂接着剂，其具有高可挠曲性、抗吸湿及阻燃性，且对金属及塑料基材具有良好的接着强度。

使用方法：

撕掉半固化胶片表面离型膜，将该半固化胶片未含pet膜的平面与线路基板结合，再将pet膜移除，并将该半固化胶片移除pet膜的一面与一铜箔接合，再经由高温及高压压合，使该半固化胶片固化形成铜箔与线路基板间的绝缘层。

软性铜箔基材又称为挠性覆铜板，柔性覆铜板，软性覆铜板，fccl，flexible copper clad laminate，fpc电路板基材；软性铜箔基材分为单面铜箔基材，双面铜箔基材，无胶铜箔基材，压延铜箔基材，电解铜箔基材，覆铝箔基材，pi覆铜箔基材，pet铜箔基材，半固化胶片，纯铜箔板材，单面胶覆盖膜，双面胶覆盖膜，无胶pi薄膜。柔性覆铜板主要用于加工挠性印制电路（fpc），广泛用于各种电子产品。

挠性覆铜板具有轻、薄和可挠性的特点，有利于电子产品实现轻、薄、短小化。轻可以减少最终产品的重量；薄可以提高柔软度.加强再有限空间内作三度空间的组装；短可以省去多余排线的连接工作；小可以有效降低产品体积.增加携带上的便利性。

挠性覆铜板是由基膜和铜箔、采用胶粘剂经热压复合而成的。绝缘基膜主要有聚酯（pet）薄膜、聚酰亚胺（pi）薄膜、聚酯酰亚胺薄膜、氟碳乙烯薄膜、亚酰胺纤维纸、聚丁烯对酞酸盐薄膜等。挠性覆铜板用的导体材料金属导体箔有电解铜箔（ed）、和压延铜箔（ra）、铝箔和铜－铍合金箔。胶粘剂是三层法挠性覆铜板的重要组成部分，它直接影响挠性覆铜板的产品性能和质量。用于挠性覆铜板胶粘剂的主要有聚酯类胶粘剂、丙烯酸类胶粘剂、环氧或改性环氧类胶粘剂、聚酰亚胺类胶粘剂、酚醛－缩丁醛类胶粘剂等。

软性铜箔基材绝缘基膜聚酰亚胺（pi）薄膜常用厚度规格有12.5μm、15μm、20μm、25μm、30μm、35μm、40μm、45μm、50μm、75μm、100μm、125μm、150μm、175μm、200μm、200μm、225μm、300μm、350μm、400μm、450μm、500μm。聚酰亚胺（pi）薄膜颜色有黑色pi补强板，黄色pi覆盖膜，白色coverlay，透明膜聚酰亚胺补强板，棕色pi覆铜板。

柔性覆铜板金属导体铜箔常用厚度规格有3μm、6μm、9μm、12μm、15μm、18μm、20μm、25μm、30μm、35μm、50μm、70μm、105μm、140μm、175μm、210μm、245μm、280μm、315μm、350μm、400μm、450μm、500μm。无胶铜箔基材有流延法，喷镀法，化学镀/电镀法，层压法4种制造方法。

fccl粘接剂厚度规格有2μm、5μm、8μm、10μm、12μm、15μm、18μm、20μm、25μm、30μm、35μm、40μm、45μm、50μm、60μm、70μm、75μm、100μm、125μm、150μm、200μm等。广惠科技软性铜箔基材又叫bench牌挠性覆铜板，广惠flexible copper clad laminate，百强牌fccl，growing柔性覆铜板。

flexible copper clad laminate主要宽度有225mm，250mm，260mm，265mm，270mm，280mm，290mm，300mm，305mm，320mm，330mm，340mm，350mm，410mm，420mm，430mm，440mm，450mm，540mm，610mm，630mm，770mm，820mm，1120mm，1290mm，13200mm；半固化胶片又分为15微米半固化纯胶片，25微米半固化纯胶片，50微米半固化纯胶片，75微米半固化纯胶片，100微米半固化纯胶片。

挠性印制线路板广泛地应用于计算机、电话机、继电器、陀螺仪、导弹、汽车仪表等电子设备中。挠性基材既要保证材料具有良好的化学稳定性和加工相容性，又要不损失其原有的电性能、耐热性能和机械性能。柔性覆铜板要求基材的挠曲次数要能够达到百万次以上。在加工过程中也需要材料有优良的挠曲性能，以便适应卷对卷的连续生产，进行钻孔、电镀、蚀刻等工艺过程。软性覆铜箔板长度有225mm，250mm，260mm，265mm，270mm，280mm，290mm，300mm，305mm，320mm，330mm，340mm，350mm，410mm，420mm，430mm，440mm，450mm，540mm，630mm，770mm，820mm，1120mm，1290mm，13200mm，10m，20m，50m，100m，150m，200m。苏州广惠能够根据客户要求分切成不同规格单面铜箔基材，并且快速交货。

苏州工业园区广惠科技有限公司成立于2004年4月，专业为fpc柔性电路板和pcb线路板以及ccl覆铜箔板行业（fr4），提供快速压合材料和传统压合材料以有真空压合材料的生产、加工、销售以及技术服务。主要是离型膜为主类的压合耗材有哑光离型膜、pet单硅离形膜、bopp分离膜、传压雾化膜、烧付铁板、矽铝箔板、热压硅橡胶垫、sg绿色矽胶片、真空气囊、玻璃纤维布、层压钢板、承载托盘、弹簧挡块、层压牛皮纸、ptfe特氟龙离行膜、fep耐氟龙胶片、ptfe铁氟龙胶带、tpx离型膜、tpx阻胶膜、tpx纸基膜、pet纸基膜、氟塑纸基膜、pe填充膜、pvc吸胶膜。广惠不是简单的销售产品给客户，广惠提供更多的是人性化的服务，和后期的技术支持。广惠从事电路板行业多年，有着丰富的生产经验，及问题处理能力。广惠公司坚持仔细谨慎，勤劳节俭的管理宗旨；执行满足客户,精益求精的品质方针；强化诚实守信，互惠互利的营销政策；取得了广大客户朋友信赖和支持，帮助客户创造了优秀的产品质量，良好的市场信誉和丰厚的经济效益。广惠科技层压钢板和离型膜具有规格齐全、品质稳定、价格优惠等绝对优势。

本产品的加工定制是是，品牌是苏州广惠百强(BENCH)牌，型号是EB050，机械刚性是柔性，层数是单面，基材是树脂，绝缘材料是有机树脂，绝缘层厚度是常规板，阻燃特性是VO板，加工工艺是电解箔，增强材料是复合基，绝缘树脂是聚酯树脂(PET)，产品性质是热销，营销方式是现货，营销价格是优惠，规格是Surface(36μm)+AD(50μm)+Under(36μm)=122μm，尺寸是W:250mm*L:100M